

УДК 537.312.62

©1993

**СТРУКТУРА РЕЗИСТИВНОГО
СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПЕРЕХОДА
В РЕГУЛЯРНОЙ РЕШЕТКЕ НАНОЧАСТИЦ ИНДИЯ**

*К.Х.Бабамуратов, В.В.Журавлев, Ю.А.Кумжаров, С.Г.Романов,
С.А.Хачатуров*

Измерен резистивный сверхпроводящий переход в регулярной решетке наночастиц индия характерных размеров, соединенных узкими мостиками. Обнаружена ступенчатая структура перехода. Показано, что эта структура связана с различием в критической температуре перехода каждой из групп гранул, обусловленным размерной зависимостью T_c .

Создание регулярных ансамблей из большого числа идентичных джозефсоновских контактов представляет большой интерес вследствие перспективы их использования в качестве мощных перестраиваемых генераторов СВЧ диапазона, селективных детекторов, стандартов Вольта и т.д. Основным условием успешного функционирования таких приборов является синхронная работа всех элементов системы, возможная лишь в случае близости параметров отдельных переходов и наличия эффективного и одинакового по величине взаимодействия между ними. Среди всевозможных конфигураций ансамблей слабых связей особое место занимают трехмерные наборы как системы с наибольшим возможным числом элементов. Однако опробованные к настоящему моменту системы либо имеют малое количество элементов [1], либо заведомо нерегулярные [2].

Нами была предпринята попытка создания кристаллографически упорядоченной решетки слабых связей на основе композитного материала — пористого диэлектрика, заполненного металлом. В качестве матрицы были использованы искусственные регулярные пространственные упаковки силикатных шаров (разброс размеров шаров по диаметру D не более 5%, величина D определяется условиями роста, характерная величина $D = 250$ нм), имеющие структуру благородного опала [3]. Внутреннее пустое пространство такой упаковки составлено из полостей двух типов с размерами $d_1 = 0.415D$ и $d_2 = 0.23D$ (свободный объем матрицы около 25% от общего объема). Полости строго поочередно сообщаются через окна с минимальным диаметром $d_3 = 0.155D$. Металл, введенный в полости из расплава под давлением, образует после застыивания многосвязную систему гранул, форма которых в точности повторяет геометрию полостей матрицы, а симметрия решетки гранул соответствует симметрии упаковки шаров. Токоведущий путь в этой системе представляет собой чередование гранул d_1 и d_2 , соединенных мостиками

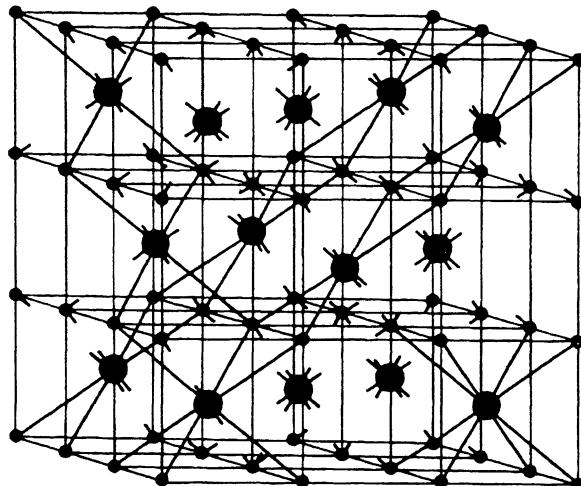


Рис. 1. Схематическое изображение решетки In гранул (взято из [4]).

Большие кружки соответствуют гранулам d_1 , малые — d_2 , соединяющие их отрезки — мостиками d_3 .

d_3 (рис. 1) [4]. В случае сверхпроводникового наполнителя любой элемент гранула–мостик–гранула можно рассматривать как джозефсоновский элемент типа мостика переменной толщины. Следует отметить, что метод матричной изоляции позволяет избежать ряда проблем, возникающих при традиционных способах приготовления ансамблей контактирующих малых частиц: а) неодинаковость геометрических характеристик точек касания соседних частиц; б) неконтролируемость толщины окисного слоя в области контакта частиц; в) нерегулярность упаковки частиц.

Полученный объект демонстрирует характерные для джозефсоновских систем свойства [5,6], однако ряд эффектов, например ступени Шапиро, наблюдать не удалось. Это обстоятельство побудило предпринять более подробное исследование поведения полученных систем с целью выявления связи их физических характеристик со структурой.

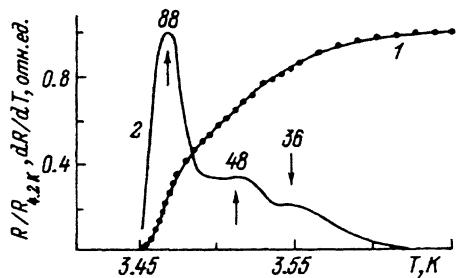
Настоящая работа посвящена анализу формы сверхпроводящего перехода в регулярной решетке многосвязных наночастиц. Известно, что форма сверхпроводящего резистивного перехода (т.е. перехода с транспортным током) зависит от фазового состава, примесей и структуры образца. В частности, для систем со слабыми связями на форму перехода оказывают влияние характер вхождения в них магнитного потока [7], размерная зависимость индивидуальных сверхпроводящих свойств малых частиц [8], а также возможность взаимовлияния соседних слабых связей [9].

Для измерений были использованы ансамбли матрично изолированных частиц In (обозначаемые далее O-In). Образцы прямоугольной формы размерами $3 \times 1 \times 0.5$ мм были снабжены 4Ag или Pb контактами, выращенными электрохимически на верхней грани образца с использованием формирующей маски. Внешнее магнитное поле создавалось соленоидом, экранировки от поля Земли не было. Измерения были проведены как на постоянном, так и на переменном токе частотой до 8 кГц. Типичное сопротивление образца O-In при 4.2 К $R_{4.2} = 1$ мОм, отношение $R_{300}/R_{4.2} = 12$.

На рис. 2 приведены зависимости $R(T)$ в области сверхпроводящего перехода без приложения магнитного поля и ее производная dR/dT . Тем-

Рис. 2. Форма резистивного перехода образца O-In $R(T)$ (1) и его производная по температуре (2).

Стрелками указаны положения максимумов производной; числа возле стрелок указывают размер гранул (нм) In, отвечающий данной температуре.



пература обращения в нуль сопротивления образца $T(R = 0) = 3.456$ К превышает T_c In на 0.049 К, что в первом приближении определяется размерами гранул, составляющих образец [8]. Как видно из рис. 2, переход размыт в области $\Delta T = 0.19$ К, причем он имеет пологую часть от 3.65 до 3.48 К и более резкое падение ниже 3.48 К. Это свидетельствует либо о значительной неоднородности образца, либо о флюктуационном размытии перехода, а возможно, и о совместном влиянии обоих факторов.

Многоступенчатый сверхпроводящий переход может реализоваться в системе связанных сверхпроводящих частиц либо в результате размерной зависимости T_c при наличии дискретного по типоразмерам набора гранул, либо в случае больших гранул ($d > \xi$ — длины когерентности), связанных посредством туннельного взаимодействия [10]. Второй случай вряд ли применим к исследуемой системе, которая является ансамблем слабых связей, т.е. мостиков с непосредственной проводимостью, обладающим джозефсоновскими свойствами, несмотря на относительно небольшую геометрическую модуляцию токоведущего канала.

Следует отметить, что локальные дефекты, примеси и напряжения будут оказывать малое влияние на форму перехода всего ансамбля в силу усреднения по большому числу переходов (до 10^{12} в образце).

Производная dR/dT позволяет отчетливо выявить особенности сверхпроводящего перехода, связанные со слабо выраженным ступенчатым в зависимости $R(T)$. Вид этой кривой дает основание предположить, что сверхпроводящий переход O-In состоит из трех последовательных по температуре переходов, причем положения максимумов зависимости dR/dT на оси T можно сопоставить с T_c этих переходов (рис. 2). Используя для оценки в первом приближении эмпирическую формулу, выведенную для пленок In и связывающую характерную толщину пленки d (нм) с T_c (К): $T_c = 3.41 + 51/d$ [11], можно сопоставить каждой T_c свой размер d : $d_1 = 88$, $d_2 = 48$ и $d_3 = 36$ нм. Первые две величины хорошо согласуются с геометрическими размерами полостей матрицы d_1 и d_2 при $D = 212$ нм (D задан условиями роста матрицы и имеет индивидуальное значение для каждого образца). Принимая во внимание зависимость T_c от измерительного тока, можно предположить, что для размера d_3 истинная T_c несколько выше, так как невозмущающая величина тока в данном случае (рис. 2) еще не была достигнута (экстраполяция по геометрическому соотношению при данном D дает $d_3 = 31$ нм).

Наложение внешнего магнитного поля 150 Э вызывает снижение $T(R = 0)$ O-In до 3.2 К (рис. 3). В случае массивного In, имеющего критическое поле $H = 283$ Э, сдвиг ΔT_c составил бы в таком поле 1.07 К; в случае O-In оказалось $\Delta T_c = 0.256$ К, что соответствует увеличению H до 2000 Э. Естественно, это изменение связано со структурой образца.

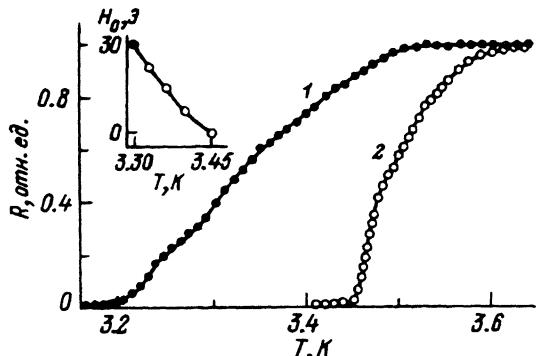


Рис. 3. Влияние внешнего магнитного поля (1 — 150, 2 — 0 Э) на форму резистивного перехода.

На вставке — начальный участок зависимости критического магнитного поля от температуры.

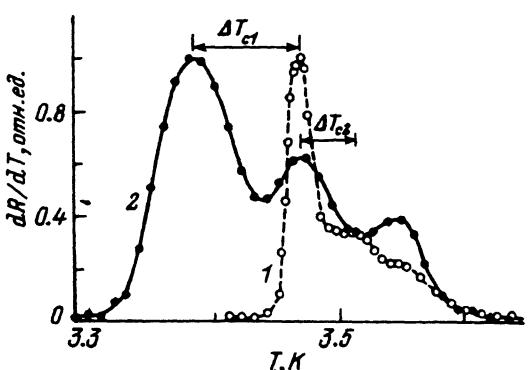


Рис. 4. Производные зависимости $R(T)$ в отсутствие внешнего магнитного поля и в поле 30 Э.

Отрезками указаны сдвиги максимумов производной.

гранулы которого имеют размер, меньший глубины проникновения магнитного поля $d < \lambda$ [8]. Наблюданное уширение перехода в магнитном поле характерно для сверхпроводящих систем со слабыми связями в отличие от массивных сверхпроводников, для которых переход сдвигается практически без уширения.

Начальный участок зависимости $H_c(T)$ представлен на вставке к рис. 3. Видно, что он имеет отрицательную кривизну (в отличие от нормального пересечения оси такой зависимостью в случае массивного сверхпроводника), что характерно для низкоразмерных гранулированных сверхпроводников [8].

Так как структура резистивного сверхпроводящего перехода сохраняется при наложении слабого магнитного поля и даже становится более ярко выраженной, то оказалось возможным выделить сдвиги ΔT_{c1} для каждого типоразмера составляющих O-In частиц. В поле 30 Э $\Delta T_{c1} = 0.088$ и $\Delta T_{c2} = 0.047$ К (рис. 4), т.е. гранулам с большим размером, соответствует больший сдвиг, причем $\Delta T_{c1}/\Delta T_{c2} = d_1/d_2$.

По-видимому, единственным фактором, сглаживающим ступенчатый вид зависимости $R(T)$, является флюктуационное размытие сверхпроводящих переходов в гранулах каждого типоразмера, составляющих O-In. Очевидно, что флюктуационный ток должен сказываться тем заметней, чем меньше размер флюктуирующей области, т.е. в мостиках меньшая выделенность ступени, соответствующей переходу в мостиках, объясняется маскирующей ролью этого тока [12].

В целом мы можем утверждать, что изученный объект является ансамблем дискретных по типоразмерам гранул, так как после усреднения

по большому ансамблю в его физических свойствах отражается наличие каждого из трех геометрических выделенных размеров.

Список литературы

- [1] Clark T.D. // Phys. Rev. B. 1974. V. 8. P. 137-162.
- [2] Габович А.М., Моисеев Д.П. // УФН. 1986. Т. 150. С. 599-623.
- [3] Sanders J.V. // Nature. 1964. V. 204. P. 35-38.
- [4] Балакирев В.Г., Богомолов В.Н., Кумзеров Ю.А., Петрановский В.П., Романов С.Г., Самойлович Л.А. // Кристаллография. 1992. Вып. 6.
- [5] Богомолов В.Н., Журавлев В.В., Колла Е.В., Кумзеров Ю.А. // Письма в ЖЭТФ. 1982. Т. 36. С. 365-368.
- [6] Богомолов В.Н., Журавлев В.В., Кумзеров Ю.А., Романов С.Г. // ФТТ. 1990. Т. 32. № 1. С. 321-323.
- [7] Van der Zant H.S.J., Rijken H.A., Mooij J.E. // J. Low Temp. Phys. 1990. V. 79. P. 289-310.
- [8] Hindley N.K., Watson J.P.H. // Phys. Rev. 1969. V. 183. P. 525-528.
- [9] Jin B.Y., Ketterson J.B. // Adv. in Phys. 1989. V. 38. P. 189-366.
- [10] Deutscher G., Imry Y., Gunter // Phys. Rev. B. 1974. V. 10. P. 4598-4606.
- [11] Vogel H.E., Garland M.M. // J. Appl. Phys. 1967. V. 38. P. 5116.
- [12] Abraham D.W., Lobb C.J., Tinkham H., Klapwijk T.M. // Phys. Rev. B. 1982. V. 26. P. 5268-5272.

Физико-технический институт
им. А.Ф. Иоффе РАН
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
29 сентября 1992 г.
В окончательной редакции
21 января 1993 г.
